



## 試料作製 “ワンポイントアドバイス” シリコンチップの入った実装品の研磨 ①切断・埋込

破壊のない切断をするための一次埋め込み→切断→二次埋め込みの解説をします。

### <ポイント>

- 埋め込みをして切断しましょう。  
理由：基盤とパッケージの振動に差が生じて、クラックが大きくなるなど本来の姿を具現化できない可能性がある。
- Siチップの切断にはダイヤモンド切断砥石LCを使用しましょう。  
理由：Siチップは脆弱なためLCが最適です。
- 二次埋め込み可能な大きさにカットします。  
理由：自動研磨機に掛けられる試料サイズにします。

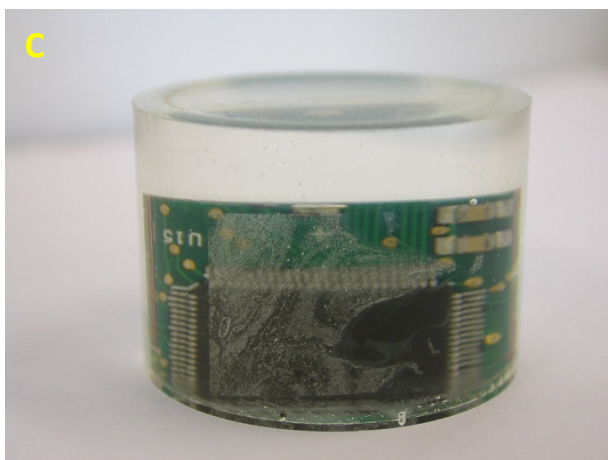
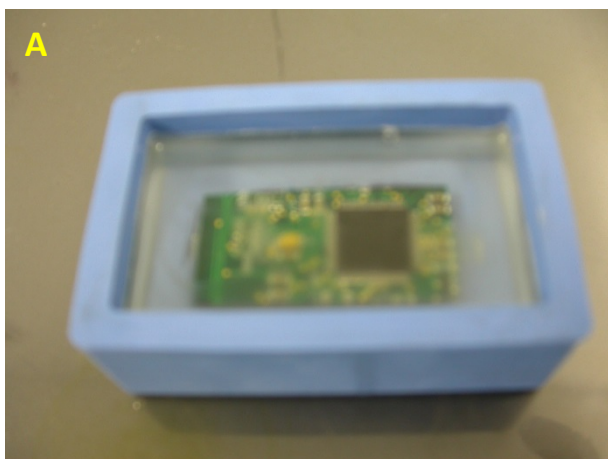


図 A：一次埋め込み

図 B：解析部近傍の切断面

図 C：研磨用に二次埋め込みした試料

動画では手順を追って説明しています。  
ビューラーホームページに掲載しています。

<https://www.buehler.jp/buehler-videos.php>

次回は、今回の試料の研磨です。